

拒絶理由通知書

| | |
|----------|-----------------|
| 特許出願の番号 | 特願2004-533817 |
| 起案日 | 平成21年 2月25日 |
| 特許庁審査官 | 長谷山 健 9171 4L00 |
| 特許出願人代理人 | 谷 義一(外 1名) 様 |
| 適用条文 | 第36条 |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。

理 由

この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

(請求項) 6

「前記基板を前記第2チャンバーに移動させて金属膜を蒸着する段階と」という記載では「金属膜を蒸着する段階」を「第2チャンバー」のいかなる部分(中間膜を基準とした上部又は下部)で行うのかが不明確で、請求項1との対応関係が明らかではない。

(請求項) 7

「熱処理工程を行う段階をさらに含む」という記載では「熱処理工程」をいかなる部分(第1チャンバー、第2チャンバー(中間膜を基準とした上部又は下部))で行うのかが不明確で、請求項1との対応関係が明らかではない。

(請求項) 8, 10

「前記第2チャンバーで犠牲シリコン層を成長させる段階」という記載では「犠牲シリコン層を成長させる段階」を「第2チャンバー」のいかなる部分(中間膜を基準とした上部又は下部)で行うのかが不明確で、請求項1との対応関係が明らかではない。

(拒絶の理由を発見しない請求項)

この拒絶理由通知書中で指摘した上記請求項以外の請求項 1-5, 9, 11-14 に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

(補正に際しての留意点)

(1) 補正は、この出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない(特許法第17条の2第3項)。

また、補正の際には、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、この出願の願書に最初に添付した明細書又は図面の根拠となる記載(段落番号、図面番号等)を具体的に明示した上で主張されたい。

(2) 明細書を補正した場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(特許法施行規則様式第13備考6)。

(この拒絶理由通知書についての問い合わせ先)

- ・特許審査第三部 半導体機器(半導体集積回路) 長谷山 健
- ・電話:03-3501-1867/ファクシミリ:03-3501-0673
- ・問い合わせに際しては、下記URLに掲載の『面接ガイドライン【特許審査編】』「5. 電話ファクシミリ等による連絡」に沿って対応してください。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/mensetu_guide/tokkyo.pdf

(先行技術文献調査結果の記録)

調査した分野 (IPC)

H01L 21/28-21/288, 21/3205, 21/3213, 21/44-21/445, 21/768,

H01L 23/52-23/522,

H01L 29/40-29/49, 29/872

先行技術文献

1. 特開平11-289089号公報
2. 特開平4-155850号公報
3. 特開平2-68927号公報
4. 特開平11-31669号公報
5. 特開平7-86208号公報
6. 特開平6-169018号公報
7. 特開平5-347270号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。